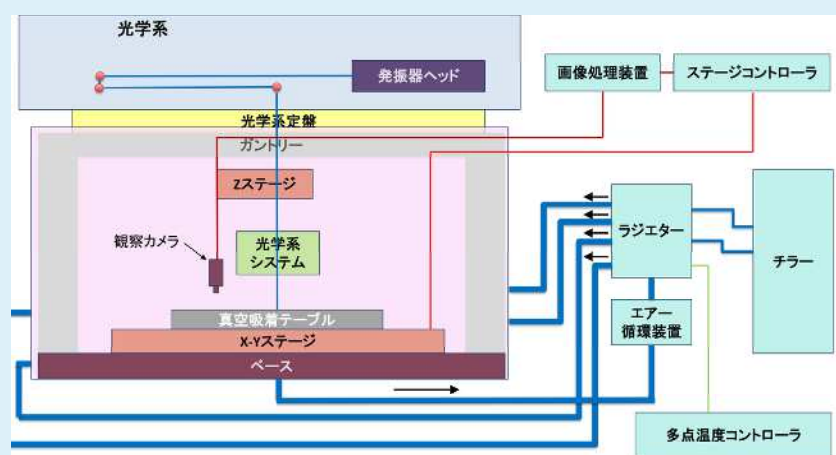


5Gの急速な普及に対応するための プローブカード加工技術の高度化への挑戦！

技術概要

さらなる高密度化・高精度化が求められる
半導体の検査部品であるプローブカードの穴あけ加工について
これまで難しかった位置決め精度 $\pm 2\mu\text{m}$ 以下 という
レーザー加工技術の構築に成功



レーザー加工機構成



リニアモータ駆動テーブル

【特徴】

- 加工テーブル
ボールねじ → リニアモータ駆動
- 温調ユニット
温度データのフィードバック制御



温調ユニット

5Gの普及における技術的課題を先取りしてレーザー加工機仕様に反映
お客様の要求仕様を達成し、加工技術の差別化と需要の獲得を実現

令和3年度

埼玉県社会課題解決型新技術・新製品開発支援事業費補助事業